



## THERMOSPOT®

La famiglia Temptronic® ThermoSpot di sistemi di contatto diretto da banco fornisce una fonte efficiente per la caratterizzazione della temperatura IC, compresi i dispositivi ad alta potenza.

Altamente reattivo e affidabile, l'unità alimenta una testa della sonda termica attraverso un ombelicale flessibile, senza l'uso di moduli termoelettrici. La sonda termica è progettata con un ThermoBridge™ intercambiabile per accoppiarsi direttamente al tuo IC o altro dispositivo in prova.

Utilizzando una tecnologia di refrigerazione proprietaria, ThermoSpot è in grado di eseguire cicli termici senza la preoccupazione del degrado del raffreddamento, così comune con i moduli termoelettrici impiegati in sistemi competitivi. Inoltre, questi sistemi offrono la più elevata capacità di raffreddamento dei sistemi a contatto diretto oggi sul mercato.

### RAFFREDDAMENTO AFFIDABILE AD ALTA CAPACITÀ:

- Ciclo termico ad alta affidabilità senza moduli termoelettrici
- Intervallo di temperatura: da -65 a 175 °C
- Potenza di raffreddamento:
- 40 W a -40 °C per dispositivi a bassa potenza
- 55 W a -55 °C e 120 W a -40 °C.
- Velocità di transizione: fino a <35 secondi tra 25 e -40 °C
- Collegamento termico semplice e sicuro al DUT inserito nel circuito o testato
- Controller touch-screen: temperature programmabili dall'utente, rappresentazione grafica, registrazione dei dati
- Opzioni di comunicazione: Ethernet, USB, IEEE, RS232



MODELLO	DESCRIZIONE	RANGE TEMPERATURA
DCP-1	Lower power devices up to 25W @ -40°C	-55 to +200°C
DCP-2	Higher power devices up to 55W @ -55°C	-65 to +180°C

ELEXIND S.p.A.

Via A. Erba 35/37 - 20066 Melzo (MI) - Italy - T. +39 02.92.72.15.1 r.a. - F. +39 02.92.10.33.89  
 info@elexind.it

© Elexind S.p.A. - Tutti i marchi e le immagini appartengono ai legittimi proprietari.